

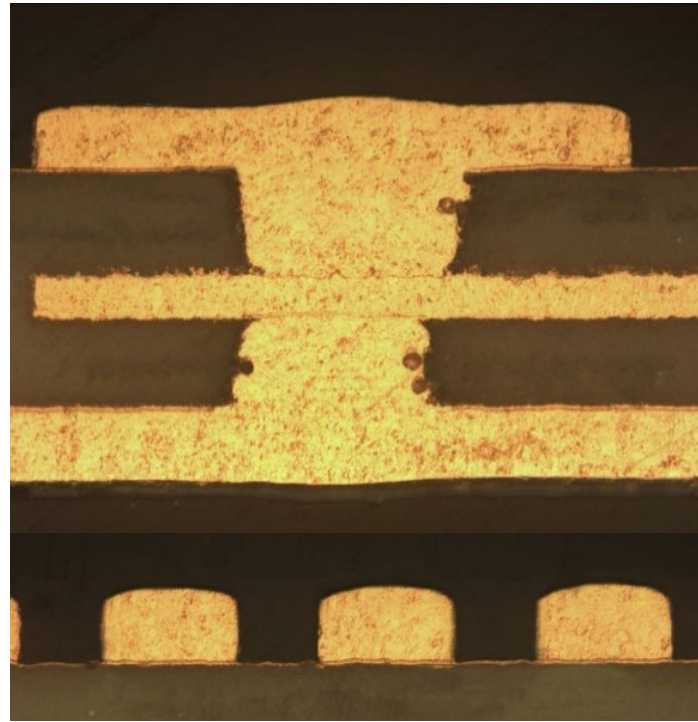
Systemek UVF 100

RDL 应用的填盲孔与细线路二合一电镀

速度、可靠性、一致性。

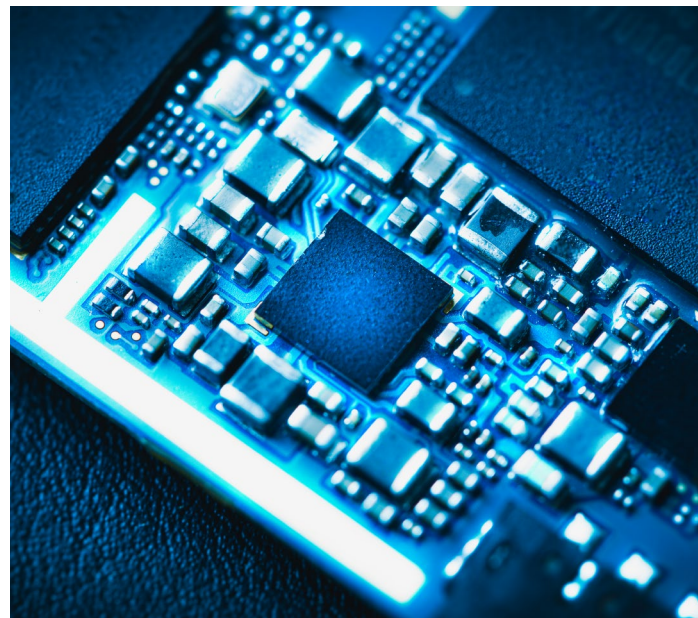
Systemek UVF 100 是一种先进的直流酸铜图形电镀工艺，能在单一溶液中填盲孔、激光钻 X 型孔和电镀细线路。该系统可高效填盲孔、X 型孔，同时保持出色的线路轮廓以及线路和焊盘的共同平面性。

由于线路轮廓和共同平面性对 RDL 应用至关重要，Systemek UVF 100 的先进技术使它成为 RDL 应用的完美选择。二合一功能的 Systemek UVF 可与 Systemek SAP (SAP) 和嵌入式线路 (ETS) 技术相结合，扩展既有产线的能力以实现当今最先进的 IC 载板设计。符合 IPC 6012D、DS、DA 和 6013D 定义的所有标准。



主要特性优点

- 单步骤中电镀细线路和填盲孔
- 在所有线路形状具有出色的共平面性，R 值始终小于 2 微米
- 峰值高度到边缘高度小于 15%
- 实现高性能填孔， $<5 \mu\text{m}$ 凹陷、 $<3 \mu\text{m}$ 过填和表面铜厚度在 10 至 $15 \mu\text{m}$ 之间。
- 添加剂系统完全可 CVS 分析，实现高度工艺控制



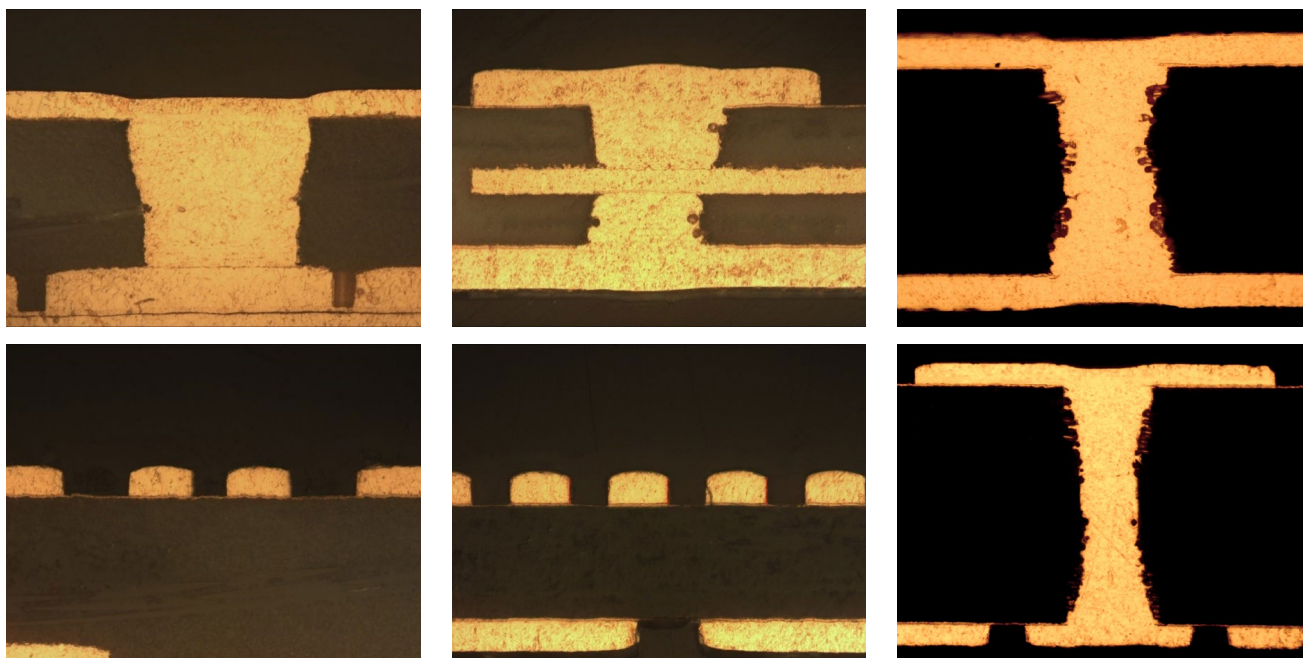
MacDermid Enthone

System UVF 100

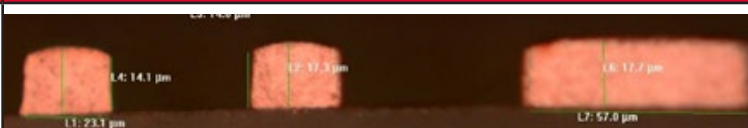
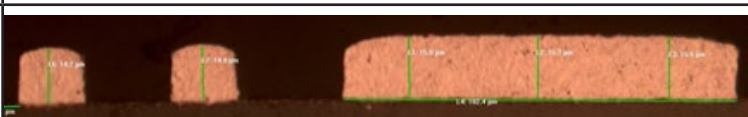
RDL 应用的填盲孔与细线路二合一电镀

广泛的电镀铜选构和设计应用。

System UVF 100 是一种多功能铜电镀工艺,可处理多种 IC 载板应用。载板制造商可以单步骤电镀生产各种铜选构,包括填盲孔、填 X 型孔 和细线 RDL图案电镀。该工艺为载板制造商带来了面板级封装的机会,从硅晶圆级封装设计扩展到有机材料面板级封装。



优秀的铜垫到线路高度均匀性 / 线路轮廓

线路宽度	铜垫宽度	平均 R 值	Profile %	微切片示例
25 μm	50 μm	0.5 μm	12%	
15 μm	100 μm	1.5 μm	15%	

System UVF 100 提供的精确电镀控制,允许线路和铜垫之间具有出色的共平面性。



macdermidalpha.com

MacDermid Enthone 为 MacDermid Alpha Electronics Solutions 旗下的产品品牌名称。© 2020 MacDermid, Inc及其集团附属公司版权所有。标识有“(R)”和“TM”是 MacDermid, Inc及其集团附属公司在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。